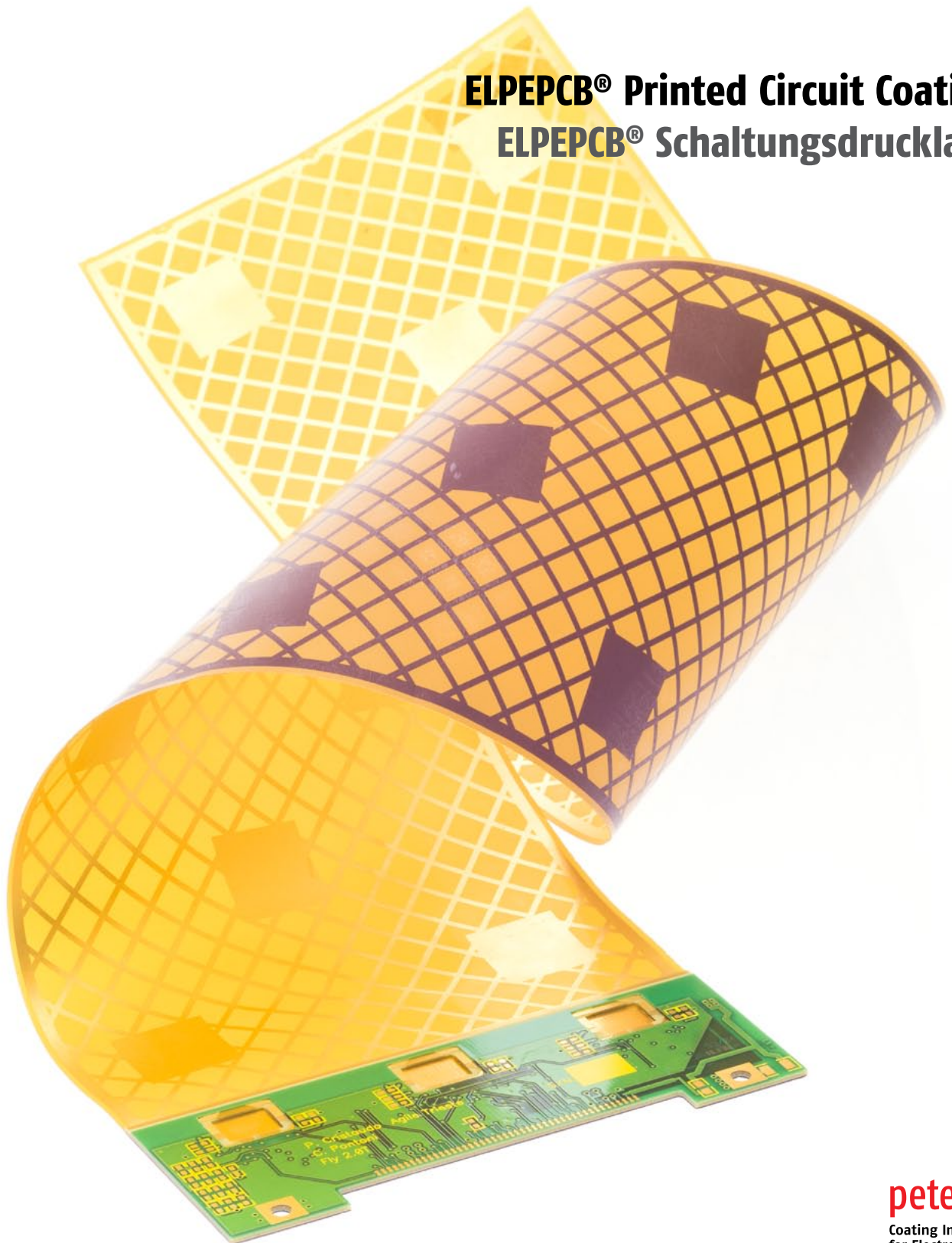


ELPEPCB®

peters

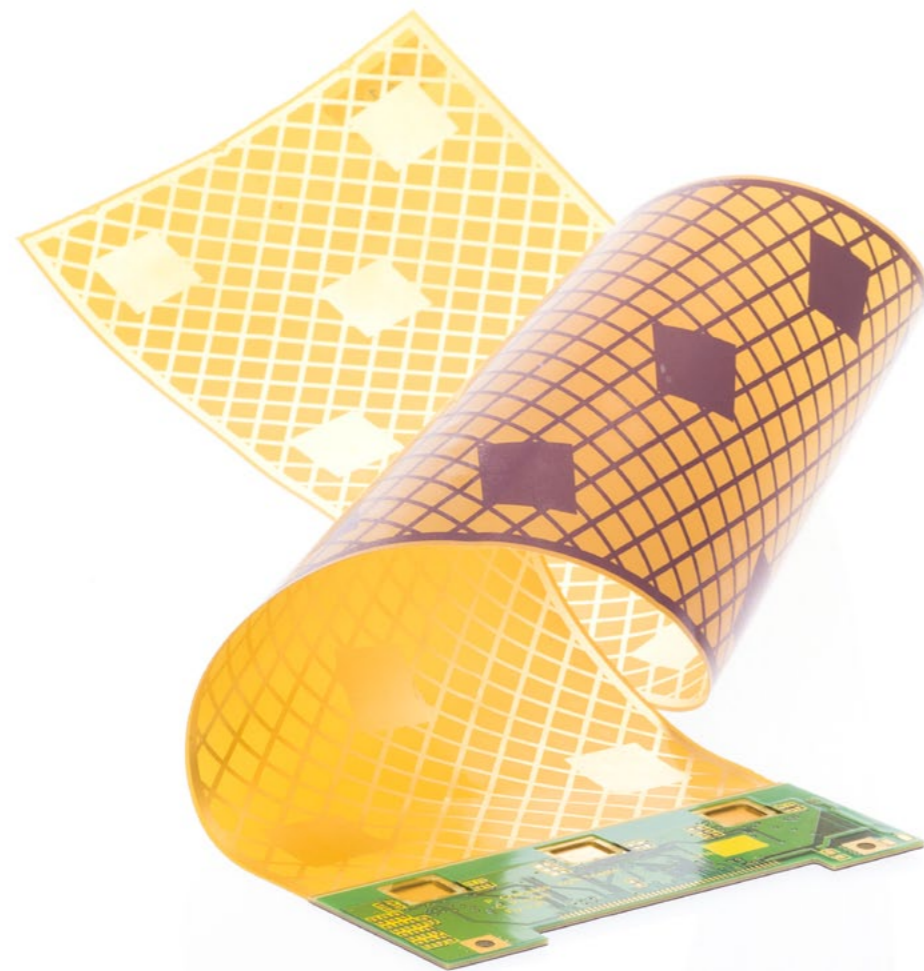
ELPEPCB® Printed Circuit Coatings

ELPEPCB® Schaltungsdrucklacke



peters

Coating Innovations
for Electronics



Printed Circuit Coatings










Schaltungsdrucklacke

The complete range of printed circuit coatings which fulfil highest demands in pcb manufacturing



Das komplette Programm an Schaltungsdrucklacken, die höchste Anforderungen bei der Herstellung von Leiterplatten erfüllen.

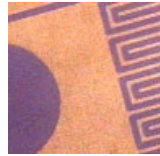
Legend / Legende

Field of use Einsatzgebiet

-  Automotive
-  Aerospace
-  Consumer
-  Industrial
-  Lighting
-  Medical
-  Solar
-  Communication
-  Defense

Color Farbe

-  Colorless Transparent / farblos transparent
-  Color / Farbe



ELPEPCB® Etch resists, plating resists and ELPEMER® photoresists

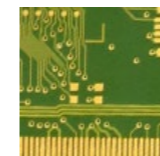
ELPEPCB® Ätz-, Galvanoresists und ELPEMER® Fotoresists

For the creation of fine and ultra-fine trace images on inner and outer layers; excellent adhesion and high surface hardness

zur Herstellung von feinen und feinsten Leiterstrukturen auf Innen- und Außenlagen; ausgezeichnete Haftfestigkeit und hohe Oberflächenhärte

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
ELPEMER® photoresist	Excellent resolution, capable of representing ultra-fine traces < 50 µm; very low exposure energy; quick to dry; for all standard application processes; strippable in filterable flakes, promoting reduced waste water contamination and longer standing time of the stripper solution hervorragendes Auflösungsvermögen, auch feinste Leiter < 50 µm darstellbar, sehr geringe Belichtungsenergie und schnelle Trocknung; für alle gängigen Applikationsverfahren; strippbar in filtrierbare Fladen für eine reduzierte Abwasserbelastung und verlängerte Standzeit der Stripperlösung	
ELPEPCB® ELPEMER® RC 2054 HR series	<ul style="list-style-type: none"> Etch resist Application by roller coating, curtain coating, dip coating Marked colour change during exposure enables good visual inspection 	●
ELPEPCB® ELPEMER® SD 2054	<ul style="list-style-type: none"> Ätzresist Applikation im Walzlackier-/Roller Coating-Verfahren, Vorhanggießverfahren, Tauchverfahren deutlicher Farbumschlag beim Belichten ermöglicht gute visuelle Kontrolle 	●
Thermal curing etch and plating resists Thermisch härtende Ätz- und Galvanoresists	High-definition application by screen printing konturenscharfe Applikation im Siebdruck	
ELPEPCB® SD 2052 AL series	<ul style="list-style-type: none"> Etch resist Resistant to pH 9 Alkaline-strippable 	● ●
ELPEPCB® SD 2149 SIT-HS	<ul style="list-style-type: none"> Ätzresist beständig bis pH 9 alkalisch strippbar 	●
ELPEPCB® SD 2149 SIT-HS	<ul style="list-style-type: none"> Plating resist for use in Secondary Imaging Technology (SIT), protects metal surfaces during electroless Ni/Au process (ENiG), thus enabling an additional surface finish Good adhesion to copper and solder resists Alkaline- or solvent-strippable 	●
ELPEPCB® SD 2154 E	<ul style="list-style-type: none"> Galvanoresist für den Einsatz in der Secondary Imaging Technology (SIT), schützt Metalloberflächen während des chemisch Ni/Au-Prozesses (ENiG) und ermöglicht so neben Ni/Au eine weitere Endoberfläche gute Haftfestigkeit auf Kupfer und Lötstopplacken alkalisch oder in Lösemitteln strippbar 	●
ELPEPCB® SD 2154 E	<ul style="list-style-type: none"> Elastic etch and plating resist also suitable for air drying Outstanding resistance over the whole pH range, also in cyanidic baths Solvent-strippable 	●
ELPEPCB® SD 2154 E	<ul style="list-style-type: none"> elastischer, auch lufttrocknender Ätz- und Galvanoresist überragende Beständigkeit im gesamten pH-Bereich, auch in cyanidischen Bädern mit Lösemitteln strippbar 	●

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
UV curing etch and plating resists UV-härtende Ätz- und Galvanoresists	High-definition application by screen printing, alkaline-strippable konturenscharfe Applikation im Siebdruck, alkalisch strippbar	
ELPEPCB® SD 2050 UV	<ul style="list-style-type: none"> Etch and plating resist, resistant to pH 9 Capable of representing 150 µm structures Suitable to etch 400 µm thick copper 	●
ELPEPCB® SD 2058 UV-FS	<ul style="list-style-type: none"> Ätz- und Galvanoresist, beständig bis pH 9 Strukturen von 150 µm darstellbar kann beim Ätzen von 400 µm hohem Kupfer eingesetzt werden 	●
ELPEPCB® SD 2059 UV-AL-T	<ul style="list-style-type: none"> Etch resist, resistant to acid baths Capable of representing 150 µm structures Strippable in filterable flakes, promoting reduced waste water contamination and longer standing time of the stripper solution 	●
ELPEPCB® SD 2059 UV-AL-T	<ul style="list-style-type: none"> Ätzresist, beständig in sauren Bädern Strukturen von 150 µm darstellbar strippbar in filtrierbare Fladen, für reduzierte Abwasserbelastung und verlängerte Standzeit der Stripperlösung 	●
ELPEPCB® SD 2059 UV-AL-T	<ul style="list-style-type: none"> Etch and plating resist, resistant to pH 9 Capable of representing 150 µm structures 	●
ELPEPCB® SD 2059 UV-AL-T	<ul style="list-style-type: none"> Ätz- und Galvanoresist, beständig bis pH 9 Strukturen von 150 µm darstellbar 	●
ELPEPCB® SD 2150 UV-AL-FS	<ul style="list-style-type: none"> Etch and plating resist, resistant to acid baths Capable of representing 250 µm structures For flexible circuits and roll-to-roll application Strippable in filterable flakes, promoting reduced waste water contamination and longer standing time of the stripper solution 	●
ELPEPCB® SD 2150 UV-AL-FS	<ul style="list-style-type: none"> Ätz- und Galvanoresist, beständig in sauren Bädern Strukturen von 250 µm darstellbar für flexible Schaltungen sowie für den Auftrag von Rolle zu Rolle strippbar in filtrierbare Fladen, für reduzierte Abwasserbelastung und verlängerte Standzeit der Stripperlösung 	●



ELPEPCB® Solder resists / ELPEPCB® Lötstopplacke

Enable simultaneous "complete soldering" and selective soldering, compatible with lead-free soldering processes, for rigid, flex-rigid and flexible pcbs, excellent adhesion

ermöglichen die sogenannte Komplett-Lötung bei gleichzeitig selektiver Lötung, kompatibel mit bleifreien Lötprozessen, für starre, starr-flexible und flexible Leiterplatten, hervorragende Haftfestigkeit

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
Photoimageable ELPEMER® solder resists	Excellent resolution, capable of representing finest structures (ink dams), for all standard application processes, UL approvals in acc. with UL File No. E80315	
Fotostrukturierbare ELPEMER® Lötstopplacke	hervorragendes Auflösungsvermögen, auch feinste Strukturen (Lackstege) darstellbar, für alle gängigen Applikationsverfahren, UL-Zulassungen gemäß UL File No. E80315	
ELPEPCB® ELPEMER® SD 2463 FLEX-HF series	<ul style="list-style-type: none"> Application by screen printing, for printing on flexible base materials, aqueous-alkaline developable Excellent resolution down to 30 µm Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 Fulfills/exceeds IPC-SM-840E 	● ● ● ●
ELPEPCB® ELPEMER® SD 2463 FLEX-HF series	<ul style="list-style-type: none"> Applikation im Siebdruck, für den Druck auf flexiblen Basismaterialien, wässrig-alkalisch entwickelbar hervorragende Auflösung bis 30 µm halogenfrei gemäß JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 erfüllt/übertrifft IPC-SM-840E 	● ● ● ●

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
ELPEPCB® ELPEMER® 2467 series	<ul style="list-style-type: none"> For all standard application processes, aqueous-alkaline developable Outstanding thermo-mechanical properties with respect to thermal cycling resistance and permanent/high-temperature resistance Fulfil/exceed amongst others IPC-SM-840E, NASA outgassing test in acc. with ASTM E595; resistant to mould and noxious gases Halogen-free adjustments in acc. with JPCA-ES01-2003/IEC 61249-2-21 LDI versions for direct imaging 	
ELPEPCB® ELPEMER® 2469 SM-HF series	<ul style="list-style-type: none"> For all standard application processes, extremely wide processing window, developable in carbitol or butyl carbitol Outstanding thermo-mechanical properties with respect to thermal cycling resistance and permanent/high-temperature resistance Fulfil/exceed amongst others IPC-SM-840E, resistant to mould and noxious gases Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 	
ELPEPCB® ELPEMER® 2491 TSW series	<ul style="list-style-type: none"> For all standard application processes, aqueous-alkaline developable Very resistant to yellowing, even after lead-free reflow soldering processes and thermal stress, low ΔE values, in particular Δb values Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 Cracking resistant in thermal shock test (TCT -40 to + 125 °C) 	
Thermal curing solder resists Thermisch härtende Lötstopplacke	High-definition application by screen printing, UL approvals in acc. with UL File No. E80315 konturenscharfe Applikation im Siebdruck, UL-Zulassungen gemäß UL File No. E80315	
ELPEPCB® SD 2444 NB-M	<ul style="list-style-type: none"> Excellent resistance to soldering processes ausgezeichnete Beständigkeit in Lötprozessen 	
ELPEPCB® SD 2446 / ELPEPCB® SD 2496 TSW	<ul style="list-style-type: none"> Very good weathering and chalking resistance (QUV accelerated weathering test) Excellent colour resistance, even after lead-free reflow soldering and tempering processes, low ΔE values SD 2496 TSW: High reflectivity and exceptional yellowing resistance Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003/IEC 61249-2-21 	

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
ELPEPCB® SD 2462 NB / ELPEPCB® SD 2462 NB-M series	<ul style="list-style-type: none"> Excellent definition and superior conductor edge (knee) coverage SD 2462 NB-M is especially suitable as a "top coat" for thick copper technology (e.g. 400 µm technology, see also thick film fillers) Excellent chemical resistance 	
UV curing solder resists UV-härtende Lötstopplacke	High-definition application by screen printing, for "print and etch", UL approvals in acc. with UL File No. E80315 konturenscharfe Applikation im Siebdruck, für „Print and Etch“, UL-Zulassungen gemäß UL File No. E80315	
ELPEPCB® SD 2368 UV series	<ul style="list-style-type: none"> Cure thoroughly even in thicker layers Suitable for Hot-Air Levelling SD 2348 UV-SM is halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003/IEC 61249-2-21 	
ELPEPCB® SD 2460/201 UV-FLEX series	<ul style="list-style-type: none"> Resistant to HAL and lead-free reflow soldering For flexible circuits, excellent adhesion to polyimide, polycarbonate and polyester foils For cross-over technology Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 and IEC 61249-2-21 (except SD 2460/201 UV-FLEX) 	

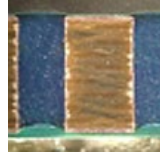


ELPEPCB® Peelable solder masks/ELPEPCB® Abziehbare Lötstopplacke

For the partial masking of pcbs as protection from direct contact with solder or as protection in electroplating processes, simple/high-definition application by screen printing, very high elasticity and tear resistance, easy to remove before and/or after the soldering process

zum partiellen Abdecken von Leiterplatten als Schutz vor direktem Kontakt mit dem Lot bzw. als Schutz in galvanischen Prozessen, einfache und konturenscharfe Applikation im Siebdruck, sehr hohe Elastizität und Einreißfestigkeit, einfache Entfernung vor und/oder nach dem Lötprozess

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
ELPEPCB® SD 2950 series	<ul style="list-style-type: none"> For leaded or lead-free wave and reflow soldering and Hot-Air Levelling, some versions allow multiple soldering For printing over carbon-conductive ink Peelable from plated-through holes Suitable as masks in electroplating and other metallisation processes Unlimited pot/processing life, solvent-free 	



ELPEPCB® Via hole fillers / ELPEPCB® Durchsteigerfüller

Securely seal via holes for vacuum adaptation during incircuit testing, prevent solder from seeping to the component side and fluxers from settling in drill holes, UL approvals in acc. with UL File No. E80315, application by screen printing

zum sicheren Verschließen von Durchsteigern (Via Holes) für die Vakuumadaption beim Incircuit-Test, verhindern das Durchsteigen von Lötlut auf die Bauteileseite und das Festsetzen von Flussmitteln in den Bohrungen, UL-Zulassungen gemäß UL File No. E80315, Applikation im Siebdruck

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
ELPEPCB® SD 2361 series	<ul style="list-style-type: none"> 100% solids content means virtually no volume shrinkage 1-pack system Thixotropic adjustment for larger drill holes (from approx. 0.5 mm to approx. 1 mm) 	●
	<ul style="list-style-type: none"> nahezu kein Volumenschwund aufgrund des 100%igen Festkörpergehalts 1-Komponenten-System thixotrope Einstellung für größere Bohrungen (von ca. 0,5 mm bis ca. 1 mm) 	
ELPEPCB® ELPEMER® VF 2467 DG	<ul style="list-style-type: none"> Photoimageable 2-pack via hole filler Basically compatible with Elpemer® 2467 solder resist series Aqueous-alkaline developable 	●
	<ul style="list-style-type: none"> fotostrukturierbarer 2-Komponenten-Durchsteigerfüller grundsätzlich kompatibel mit den Elpemer® Lötstopplacken der Reihe 2467 wässrig-alkalisch entwickelbar 	
ELPEPCB® SD 2768 NB	<ul style="list-style-type: none"> High solids content means low volume shrinkage For via-in-pad applications, no bleeding on gold or other metal surfaces 	●
	<ul style="list-style-type: none"> geringer Volumenschwund aufgrund des hohen Festkörpergehalts für Via-in-Pad-Applikationen, kein Ausbluten auf Gold- oder andere Metalloberflächen 	
ELPEPCB® ELPEMER® VF 2469 SM-HF	<ul style="list-style-type: none"> Photoimageable 2-pack via hole filler Basically compatible with the Elpemer® 2469 SM-HF solder resist series Developable in carbitol or butyl carbitol Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 	●
	<ul style="list-style-type: none"> fotostrukturierbarer 2-Komponenten-Durchsteigerfüller grundsätzlich kompatibel mit den Elpemer® Lötstopplacken der Reihe 2469 SM-HF in Butyldiglykol (BDG) oder Ethyldiglykol (EDG) entwickelbar halogenfrei gemäß JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 	



ELPEPCB® Plugging pastes / ELPEPCB® Plugging-Pasten

Bubble-free, smooth hole plugs/insulation layers in HDI/SBU technology, application by screen and stencil printing and vacuum screen printing, excellent metallisability, low thermal expansion coefficient, no cracking or delamination of the applied metallisation, UL approvals in acc. with UL File No. E80315

blasenfreie, ebene Lochfüllungen / Isolationschichten in der HDI-/SBU-Technologie, Applikation im Sieb- und Schablonendruck und Vakuum-Siebdruck, ausgezeichnete Metallisierbarkeit, geringer thermischer Ausdehnungskoeffizient, keine Rissbildung oder Delamination der aufgetragenen Metallisierung, UL-Zulassungen gemäß UL File No. E80315

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
ELPEPCB® PP 2793 series	<ul style="list-style-type: none"> Very low coefficient of thermal expansion (CTE) and high glass transition temperature (Tg) of 155 °C Minimum volume shrinkage Excellent chemical resistance, e.g. in desmear process during metallisation Tested in acc. with ASTM E595 (NASA-approved outgassing test) Long shelf life: 4 months 	●
	<ul style="list-style-type: none"> sehr geringer thermischer Ausdehnungskoeffizient (CTE) und hohe Glasübergangstemperatur (Tg) von 155°C sehr geringer Volumenschwund ausgezeichnete chemische Beständigkeit, z.B. im Desmear-Prozess während der Metallisierung geprüft nach ASTM E595 (von der NASA anerkannter Outgassing-Test) lange Haltbarkeit: 4 Monate 	
ELPEPCB® PP 2795 series	<ul style="list-style-type: none"> Application also by roller coating Higher aspect ratios possible with high-viscosity adjustment Green version for a more visually uniform appearance if no metallisation is applied Listed in NASA specification D-8202 Long shelf life: 6 months 	○ ● ●
	<ul style="list-style-type: none"> Applikation auch im Roller-Coating-Verfahren mit hochviskoser Einstellung können höhere Aspect Ratios realisiert werden grüne Einstellung für optisch gleichmäßigeres Erscheinungsbild, wenn nachfolgend nicht metallisiert wird gelistet in der NASA-Spezifikation D-8202 lange Haltbarkeit: 6 Monate 	○ ● ●



ELPEPCB® Marking inks / ELPEPCB® Signierlacke

Exceptional covering power, very good adhesion, soldering resistant, high solids content

ausgezeichnetes Deckvermögen, sehr gute Haftfestigkeit, lötlöslich, hoher Festkörpergehalt

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
Photoimageable ELPEMER® marking inks	Blanket application by screen printing, especially suitable for pilot and low-volume series' as no complex screen stencil required, capable of representing finest details	
Fotostrukturierbare ELPEMER® Signierlacke	flächige Applikation im Siebdruck, für Null- und Kleinserien besonders geeignet, da die aufwendige Siebschablonenerstellung entfällt, Darstellung feinsten Details	
ELPEPCB® ELPEMER® SD 2691 TSW	<ul style="list-style-type: none"> Aqueous-alkaline developable Outstanding yellowing resistance even after reflow soldering and tempering processes, low ΔE values 	○ ● ●
	<ul style="list-style-type: none"> wässrig-alkalisch entwickelbar außerordentliche Vergilbungsbeständigkeit auch nach bleifreien Reflow-Löt- und Temperprozessen, geringe ΔE-Werte 	
ELPEPCB® ELPEMER® SD 2618 / SD 2698	<ul style="list-style-type: none"> Aqueous-alkaline developable 	○ ● ●
	wässrig-alkalisch entwickelbar	

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
Thermal curing marking inks Thermisch härtende Signierlacke	High-definition application by screen printing konturenscharfe Applikation im Siebdruck	
ELPEPCB® SD 2597	<ul style="list-style-type: none"> 1-pack ink with long screen opening time excellent definition very good adhesion on copper, FR4 base material and solder resists 	○
ELPEPCB® SD 2696 TSW	<ul style="list-style-type: none"> 1-Komponenten-Lack mit langer Sieboffenzeit hervorragende Konturenschärfe sehr gute Haftfestigkeit auf Kupfer, FR4-Basismaterial und Lötstopplacken 	○
ELPEPCB® SD 2692 T series	<ul style="list-style-type: none"> Excellent yellowing resistance after lead-free reflow soldering and tempering processes, low ΔE values High reflectivity Very good weathering and chalking resistance (QUV accelerated weathering test) 	○ ○ ○
ELPEPCB® SD 2692 T series	<ul style="list-style-type: none"> exzellente Vergilbungsbeständigkeit nach bleifreien Reflow-Löt- und Temperprozessen, geringe ΔE-Werte hohe Remission sehr gute Witterungs- und Kreidungsbeständigkeit (QUV Schnellbewitterungstest) 	○ ○ ○
ELPEPCB® SD 2692 T series	<ul style="list-style-type: none"> Long pot/processing life: at least 6 weeks Catalysed adjustments cure faster, pot life 1 day Excellent definition due to high thixotropy Superior chemical resistance 	○ ○ ○ ○
ELPEPCB® SD 2692 T series	<ul style="list-style-type: none"> lange Topf-/ Verarbeitungszeit: mindestens 6 Wochen die katalysierten Einstellungen härten schneller, Topfzeit 1 Tag ausgezeichnete Konturenschärfe aufgrund der hohen Thixotropie hervorragende chemische Beständigkeit 	○ ○ ○ ○
ELPEPCB® SD 2617 series	<ul style="list-style-type: none"> lange Topf-/ Verarbeitungszeit: mindestens 1 Monat 	○
ELPEPCB® SD 2617 series	<ul style="list-style-type: none"> lange Topf-/ Verarbeitungszeit: mindestens 1 Monat 	○
UV curing marking inks UV-härtende Signierlacke	High-definition application by screen printing konturenscharfe Applikation im Siebdruck	
ELPEPCB® SD 2513 UV series	<ul style="list-style-type: none"> Solids content 100% Short curing times High colour stability 	○ ○ ○
ELPEPCB® SD 2513 UV series	<ul style="list-style-type: none"> Festkörpergehalt 100% kurze Aushärtezeiten hohe Farbstabilität 	○ ○ ○

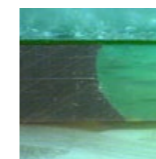


ELPEPCB® Carbon-conductive inks / ELPEPCB® Carbon-Leitlacke

to substitute gold on contact points or to conduct static charge

zur Substitution von Gold an Kontaktstellen oder zur Ableitung statischer Ladungen

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
Carbon-conductive inks Carbon-Leitlacke	<p>High-definition application by screen printing, to substitute gold, also suitable for cross-over technology and for generating printed resistors, very good adhesion to flexible base material, thus also suitable for "static flex" applications, excellent mechanical resistance, resistant to Hot-Air Levelling</p> <p>konturenscharfe Applikation im Siebdruck, zur Substitution von Gold, auch geeignet für die Herstellung von kreuzenden Leitern (Cross-Over-Technik) und das Erstellen gedruckter Widerstände, sehr gute Haftung auf flexiblem Basismaterial, daher auch für „Static Flex“ Anwendungen geeignet, hervorragende mechanische Festigkeit, beständig im Hot-Air-Levelling</p>	
ELPEPCB® SD 2842 HAL	<ul style="list-style-type: none"> Ultra-smooth surface, thus also suitable for sliding contacts 	○
ELPEPCB® SD 2842 HAL	<ul style="list-style-type: none"> sehr glatte Oberfläche, daher auch geeignet für Schleifkontakte 	○
ELPEPCB® SD 2843 HAL	<ul style="list-style-type: none"> For touch-key contacts Individual resistances possible by mixing with insulating paste SD 2803 HAL 	○
ELPEPCB® SD 2843 HAL	<ul style="list-style-type: none"> für Tippkontakte durch Mischen mit der Isolierpaste SD 2803 HAL sind individuelle Widerstände einstellbar 	○
Conductive lacquers Leitlack	<p>Prevents static build-up and conducts static charge away, for coating the insides of casings and packagings designed to protect highly sensitive electronic components from static electricity</p> <p>verhindert statische Aufladung und leitet statische Ladungen ab, zur Innenbeschichtung von Gehäusen und Verpackungen, in denen hochsensible Elektronik vor statischer Aufladung geschützt werden soll</p>	
ELPEPCB® EH 13-344	<ul style="list-style-type: none"> Application by brushing or spraying Dries at room temperature 	○
ELPEPCB® EH 13-344	<ul style="list-style-type: none"> Applikation durch Pinseln oder Sprühen bei Raumtemperatur trocknend 	○



ELPEPCB® Thick film fillers / ELPEPCB® Dickschichtfüller

Fill insulation channels in thick copper technology (e.g. 400 µm technology) by means of screen or stencil printing, solvent-free, very good soldering resistance also in lead-free soldering processes

zum Verfüllen der Isolationskanäle in der Dickkupfertechnik (z.B. der 400 µm-Technik) im Sieb- oder Schablonendruck, lösemittelfrei, sehr gute Lötbeständigkeit, auch in bleifreien Lötprozessen

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
ELPEPCB® DSF 2706 UV	<ul style="list-style-type: none"> UV curing 2-pack system UL approval in acc. with UL 94, UL File No. E80315 Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 For use on outer layers System component in thick copper technology in combination with the 2-pack solder resist SD 2462 NB-M as "top coat" 	○
ELPEPCB® DSF 2706 UV	<ul style="list-style-type: none"> UV-härtendes 2-Komponenten-System UL-Zulassung nach UL 94, UL File No. E80315 halogenfrei gemäß JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 für den Einsatz auf Außenlagen als System in der Dickkupfertechnik gemeinsam eingesetzt mit dem 2-Komponenten-Lötstopplack SD 2462 NB-M als „Top Coat“ 	○
ELPEPCB® DSF 2793	<ul style="list-style-type: none"> Thermal curing 1-pack system For the generation of thick-copper inner layers Corresponds to the best flame class V-0 in acc. with UL 94 	○
ELPEPCB® DSF 2793	<ul style="list-style-type: none"> thermisch härtendes 1-Komponenten-System zur Herstellung von Dickkupfer-Innenlagen entspricht der besten Nichtbrennbarkeitsstufe V-0 gemäß UL 94 	○



ELPEPCB® Thermal transfer pastes / ELPEPCB® Wärmeleitpasten

Highly thermally conductive systems for the thermal management of pcbs/pcb assemblies, cost-effective alternative to conventional glued heatsinks, flexible design of different heatsink geometries with existing screen printing technology, electrically insulating

sehr wärmeleitfähige Systeme für das thermische Management von Leiterplatten / Flachbaugruppen, kostengünstige Alternative zum konventionellen aufgeklebten Heatsink, flexible Gestaltung unterschiedlichster Heatsinkgeometrien mit bestehender Siebdrucktechnik, elektrisch isolierend

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
Heatsink pastes Heatsink-Pasten		
ELPEPCB® HSP 2740 ELPEPCB® HSP 2741	<ul style="list-style-type: none"> 1-pack systems with 100% solids content HSP 2740: Excellent printing properties, silk-mat surface and better chemical resistance HSP 2741: Higher flexibility, thus less impact on the evenness of the pcb; UL approval in acc. with UL File No. E80315 	
<ul style="list-style-type: none"> 1-Komponenten-Systeme mit 100% Festkörpergehalt HSP 2740: hervorragende Druckeigenschaften, seidenmatte Oberfläche und bessere Chemikalienbeständigkeit HSP 2741: höhere Flexibilität, daher geringere Beeinflussung der Planarität der Leiterplatte; UL-Zulassung gemäß UL File No. E80315 		
Thermal interface paste Thermal Interface Paste		
ELPEPCB® TIP 2792	<ul style="list-style-type: none"> 1-pack system with 100% solids content is applied as Thermal Interface Material (TIM) between the printed circuit board and the heatsink or heat-dissipating casings for a reliable thermal connection for thermo-mechanical decoupling 	
<ul style="list-style-type: none"> 1-Komponenten-System mit 100% Festkörpergehalt wird als Thermal Interface Material (TIM) zwischen Leiterplatte und Kühlkörper oder wärmeableitenden Gehäusen für eine zuverlässige thermische Anbindung eingesetzt zur thermomechanischen Entkopplung 		



ELPEPCB® Touch-up coatings / repair coatings

ELPEPCB® Ausbesserungslacke / Reparaturlacke

Remove minor mechanically caused damages to the ink surface, e.g. scratches in solder mask zur Behebung kleiner mechanisch verursachter Lackschäden, wie z.B. Kratzer im Lötstopplack

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
Touch-up lacquer Ausbesserungslack SD 2369 UV-ABL		
	<ul style="list-style-type: none"> Application by screen printing or brush Yellow-green transparent 1 pack coating UV curing 	
<ul style="list-style-type: none"> Applikation im Siebdruck oder mit dem Pinsel gelbgrün-transparenter 1-Komponenten-Lack UV-härtend 		
Repair coating Reparaturlack EH 13-767		
	<ul style="list-style-type: none"> Applikation mit dem Pinsel grün-deckender, matter 1-Komponentenlack bei Raumtemperatur trocknend, vorteilhaft für die Reparatur bestückter Baugruppen nach vollständiger Lötung, da diese häufig nicht mehr thermisch belastet werden dürfen 	
<ul style="list-style-type: none"> Application by brush Green opaque, mat 1-pack coating Dries at room temperature, beneficial for the repair of pcb assemblies after completed soldering as they often must not be exposed to further thermal stress 		

ELPEPCB® Auxiliary products for circuit printing

ELPEPCB® Hilfsprodukte für den Schaltungsdruck

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
Universal thinners / universal retarders Universal-Verdünnung / Universal-Verzögerer		
ELPEPCB® UV 5000 ELPEPCB® UZ 5100	<ul style="list-style-type: none"> For many 1- and 2-pack screen printing inks provided no other dedicated thinner or retarder is prescribed UV 5000 reduces the viscosity UZ 5100 reduces the viscosity and prolongs the screen-open time 	
<ul style="list-style-type: none"> für zahlreiche 1- und 2-Komponenten-Siebdrucklacke, sofern keine spezielle Verdünnung bzw. kein spezieller Verzögerer erforderlich ist UV 5000 reduziert die Viskosität UZ 5100 reduziert die Viskosität und verlängert die Sieboffenzeit 		
Screen openers Sieböffner		
ELPEPCB® HP 5200	<ul style="list-style-type: none"> Spray to dissolve dried printed circuit coatings from screens, no need for complicated washing processes to clean screens after work breaks Highly effective, fast action Silicone- and grease-free, meaning no surface disruptions/dewettings or smearing during subsequent printing process 	
<ul style="list-style-type: none"> Spray zum Lösen angetrockneter Schaltungsdrucklacke aus dem Drucksieb, aufwendige Waschprozesse der Siebe nach Arbeitspausen entfallen hochaktiv und schnell wirksam silikon- und fettfrei, d. h. es treten keine Oberflächenstörungen/ Entnetzungen oder Schmier-effekte beim folgenden Druckprozess auf 		
Anti-static sprays / agents Anti-Statik-Spray / Antistatikum		
ELPEPCB® HP 5500 ELPEPCB® HP 5501	<ul style="list-style-type: none"> Prevents and removes static build-up on/from nylon and polyester fabrics during the pcb printing process Reduces dust-related errors during screen printing and when processing dry resists Highly effective, simple and safe to use HP 5500 - in a practical spray can HP 5501 for application by spraying, dipping or with a brush or cloth 	
<ul style="list-style-type: none"> verhindert und beseitigt statische Aufladungen von Nylon- und Polyestergeweben beim Schaltungsdruck reduziert staubbedingte Fehler beim Siebdruck und bei der Verarbeitung von Trockenresisten hochwirksam, einfach und sicher in der Anwendung HP 5500 - die praktische Spraydose HP 5501 für den Auftrag durch Sprühen, Tauchen oder mit Pinsel/Lappen 		
Deoxidising agents Entoxidationsmittel		
ELPEPCB® HP 5625	<ul style="list-style-type: none"> Deoxidisation of copper surfaces when pretreating pcbs prior to coating/resist application Especially for conveyerised spray processes in combination with mechanical precleaning methods 	
<ul style="list-style-type: none"> Entoxidation von Kupferflächen zur Vorbehandlung von Leiterplatten vor der Lack-/Resistapplikation speziell für Durchlaufsprühverfahren in Verbindung mit mechanischen Vorreinigungsverfahren 		
Special strippers Spezial-Stripper		
ELPEPCB® HP 5707	<ul style="list-style-type: none"> Suitable for removing exposed and potentially cured photoimageable solder resists (e.g. after faulty exposure) Suitable for cleaning coating developers and resist stripper equipment, batches of cleaner can be used multiple times 	
<ul style="list-style-type: none"> zur Entfernung von belichteten und ggf. auch ausgehärteten fotostrukturierbaren Lötstopplacken (z.B. bei Fehlbelichtungen) geeignet zur Reinigung von Lackentwicklungs- und Resiststripperanlagen geeignet, Ansätze zur Anlagenreinigung können mehrfach verwendet werden 		

Product Series	Features	Colour / Application Farbe / Anwendung
Cleaning agents Reinigungsmittel	For cleaning work tools, screens and processing equipment and for use in automatic screen washers für die Reinigung von Arbeitsgeräten, Sieben und Verarbeitungsanlagen und für den Einsatz in Siebwaschanlagen	
ELPEPCB® R 5899	<ul style="list-style-type: none"> • For use in automatic screen washers, extremely high flash point (>100°C) • Low vapour pressure < 0.1 hPa at 20°C, thus not a VOC (Volatile Organic Compound) per the EU directive 1999/13/EC • Must not be declared per German dangerous goods regulations, easily biologically degradable in acc. with OECD Test 301 A <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • für den Einsatz in Siebwaschanlagen, extrem hoher Flammpunktes (> 100°C) • niedriger Dampfdruck < 0,1 hPa bei 20°C, daher kein VOC (Volatile Organic Compound) im Sinne der EU-Richtlinie 1999/13/EG • nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung, leicht biologisch abbaubar nach OECD Test 301 A 	
ELPEPCB® R 5800 series	<ul style="list-style-type: none"> • Fast and vigorous cleaning effect • R 5814/R 5817: Remove coatings from screens, tools and after faulty prints, R 5814 has a lighter odour than R 5817, R 5817 cleans quicker • R 5821: High flash point (+32°C), suitable for use in automatic screen washers and for cleaning ink processing equipment <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • schnelle und intensive Reinigungswirkung • R 5814/R 5817: zur Lackentfernung aus Drucksieben, von Arbeitsgeräten und bei Fehldrucken R 5814 ist geruchsärmer als R 5817, R 5817 weist eine schnellere Reinigungswirkung auf • R 5821: hoher Flammpunkt (+32°C), für den Einsatz in Siebwaschanlagen und zur Reinigung von Lackverarbeitungsanlagen geeignet 	
ELPEPCB® R 5851	<ul style="list-style-type: none"> • for removing solder residues from assembled pcbs <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • zur Entfernung von Lötmitelresten auf bestückten Leiterplatten 	
Defoamants Antischaummittel		
ELPEPCB® HP 5911	<ul style="list-style-type: none"> • For defoaming aqueous-alkaline developer solutions, e.g. 1% soda solution • Silicone-free; biologically degradable <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • zur Entschäumung von wässrig-alkalischen Entwicklerlösungen, z.B. 1%ige Sodalösung • silikonfrei; biologisch abbaubar 	
Solder flux lacquers Lötack		
ELPEPCB® SL 1232	<ul style="list-style-type: none"> • Protective and preserving coating, maintains the solderability of unassembled pcbs, reliably prevents the oxidation of copper traces and at the same time is a soldering aid based on modified colophony resin • Application by roller coating, dries at room temperature • Very good solderability from as low as 215°C <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz- und Konservierungslack, erhält die Lötbarkeit unbestückter Leiterplatten, verhindert zuverlässig die Oxidation von Kupferleitern und ist gleichzeitig Löt Hilfsmittel auf Basis von modifiziertem Kolophoniumharz • Applikation im Walzlackier-Verfahren (Roller Coating), trocknet bei Raumtemperatur • sehr gute Lötbarkeit bereits bei 215°C 	

Unsere Innovationen für Ihren Erfolg
Our innovations for your success

Lackwerke Peters GmbH & Co. KG
Hooghe Weg 13 • 47906 Kempen • Germany
Phone: +49 2152 2009-0
Fax: +49 2152 2009-70
www.peters.de

peters
**Coating Innovations
for Electronics**